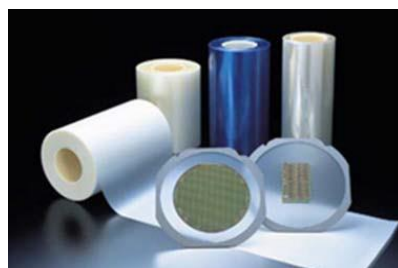
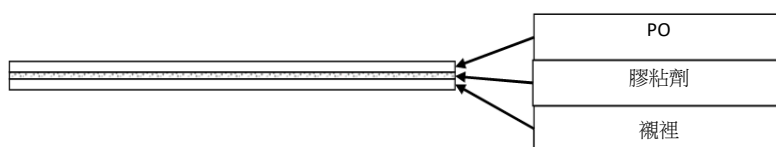


Dicing Tape (UV series)

描述

根據各類工件的要求, 隨著高品質多樣化晶片的發展, 需要高科技的切割帶。DS 生產的優雅切屑帶廣泛用於驅動 Ic、LTCC 基板、EMC 封裝基板、矽晶片、陶瓷、玻璃、鏡片等的切割和單模。

結構



特徵

項目		單位	值
寬度		mm	300
長度		M	100
厚度	班輪厚度	μm	30± 3
	膠粘劑厚度	μm	15± 2
	PO 厚度	μm	100± 3
	總厚度	μm	145± 8
粘著	粘著	g/25 mm	1300± 200
	紫外線後的粘著.	g/25 mm	35± 15

紫外線照射：460 mJ/cm²

優勢

- 對背面切屑和蕊心飛散具有出色的控制能力。
- 出色的附著力。
- 通過紫外線平滑剝落。
- 高性能的 EMC (環氧模具複合) 和其他類型的難以粘附的工件。
- 易於發佈, 適用於下一個流程
- 在 1000 級潔淨室生產